



Wysokoprędkościowe Magistrale Szeregowy w Systemach Wbudowanych - Zhang Feng

Indeks: 752742 Producent: Springer

Cena: 392.39 zł

Opis

High-speed Serial Buses in Embedded Systems

Producent: Springer

Odkryj fascynujący świat wysokich prędkości transmisji danych w systemach wbudowanych z książką „Wysokoprędkościowe Magistrale Szeregowy w Systemach Wbudowanych”. Autor, Zhang Feng, w przystępny sposób przedstawia tematykę związaną z magistralami szeregowymi, systemami wbudowanymi oraz analizą kodu RTL. Dowiedz się więcej o komunikacji między szafami, płytkami oraz chipami, która odgrywa kluczową rolę w nowoczesnych technologiach elektronicznych.

Zanurz się głębiej w świat elektroniki, obwodów oraz komunikacji sieciowej z tą unikalną publikacją. Książka zawiera 378 stron w języku angielskim, skupiając się na tematyce przesyłania danych w środowiskach wbudowanych. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą w dziedzinie elektroniki, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z systemami wbudowanymi, ta książka dostarczy Ci niezwyklej wiedzy.

„Wysokoprędkościowe Magistrale Szeregowy w Systemach Wbudowanych” to niezbędna lektura dla pasjonatów elektroniki, inżynierii komunikacyjnej oraz projektowania układów elektronicznych. Zanotuj datę premiery - 4 stycznia 2021 roku, i przekrocz granice współczesnych technologii!

- temat:** COMPUTERS / Data Transmission Systems / Electronic Data Interchange, COMPUTERS / Logic Design, Computers/Logic Design, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electronics / Circuits / General, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electronics / General, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Telecommunications, Technology & Engineering/Data Transmission Systems - General, Technology & Engineering/Electronics - Circuits - General, Technology & Engineering/Electronics - General, Technology & Engineering/Telecommunications, HC/Informatik, EDV/Informatik, HC/Technik/Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Hardcover, Softcover / Technik/Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Communications engineering / telecommunications, Communications engineering, telecommunications, Electronics engineering, Circuits & components, Computer networking & communications, Computer architecture & logic design, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Telecommunications, TECHNOLOGY & ENGINEERING, Telecommunications, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electronics / General, Electronics, General, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electronics / Circuits / General, Circuits, COMPUTERS / Data Transmission Systems / Electronic Data Interchange, COMPUTERS, Data Transmission Systems, Electronic Data Interchange, COMPUTERS / Logic Design, Logic Design, Communications Engineering, Networks, Electronics and Microelectronics, Instrumentation, Circuits and Systems, Input/Output and Data Communications, Input, Output and Data Communications, Register-Transfer-Level Implementation, Electronic Circuits and Systems, HC/Technik/Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, HC, Technik, Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, HC/Informatik, EDV/Informatik, Informatik, EDV, Informatik, High-speed data transfer;Serial bus;Embedded system;bus in FPGA;RTL code analysis;Inter-chassis communication;Board-to-board communication;Chip-to-chip communication, Electronics: circuits and components, Computer hardware, Computer

architecture and logic design, Circuits & components, Communications engineering / telecommunications, Computer architecture & logic design, Computer networking & communications, Electronics engineering, Computer architecture and logic design, Computer hardware, Computerhardware, Electronics: circuits and components, Elektronik, Nachrichtententtechnik, Telekommunikation, Rechnerarchitektur und Logik-Entwurf, Schaltkreise und Komponenten (Bauteile)

- **wiążący:** paperback
- **język:** english, english, english
- **waga przedmiotu:** 581 grams
- **strony:** 378
- **słowo kluczowe tematu:** High-speed data transfer; Serial bus; Embedded system; bus in FPGA; RTL code analysis; Inter-chassis communication; Board-to-board communication; Chip-to-chip communication, High-speed data transfer;Serial bus;Embedded system;bus in FPGA;RTL code analysis;Inter-chassis communication;Board-to-board communication;Chip-to-chip communication, High-speeddatatransfer; Serialbus; embeddedsystem; businFPGA; RTLcodeanalysis; Inter-chassiscommunication; Board-to-boardcommunication; Chip-to-chipcommunication, Non-Fiction, SCI/TECH, Science/Math, Singapore
- **kod podmiotu:** 1632, 1684, 1684, UYF, UK, UK, TJFC, TJF, TJK, UYF, TJFC, COM020010, COM036000, COM036000, TEC008010, TEC008000, TEC041000, TEC071000, TEC008010, TEC008000, TEC041000, TJFC, TJK, UYF, UT, TJF
- **grupa docelowa:** General/trade
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **kolor:** White
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.28 pounds
- **wydanie:** 1st ed. 2020
- **producent:** Springer
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 9789811518706, 09789811518706
- **autor:** Zhang, Feng
- **gatunek muzyczny:** Communications engineering, telecommunications, Electronics engineering, Circuits & components, Computer networking & communications, Computer architecture & logic design, TECHNOLOGY & ENGINEERING, Telecommunications, TECHNOLOGY & ENGINEERING, Electronics, General, TECHNOLOGY & ENGINEERING, Electronics, Circuits, General, COMPUTERS, Data Transmission Systems, Electronic Data Interchange, COMPUTERS, Logic Design, HC, Technik, Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtenttechnik, HC, Informatik, EDV, Informatik, Communications engineering, telecommunications, Electronics engineering, Electronics: circuits and components, Computer hardware, Computer architecture and logic design
- **Data publikacji:** 2021-01-04T00:00:01Z
- **numer wydania:** 1
- **nazwa przedmiotu:** High-speed Serial Buses in Embedded Systems
- **data premiery:** 2021-01-04T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-10T09:45:02.780Z

Parametry

Wydanie	1. edycja 2020
Język	Angielski
Total Pages	378
Waga	581 gramów